



样品制作承认书

客户名称: _____

客户料号: _____

样品型号: KGK-0038-AM

公司签名	品质	工程	业务	核准	公司盖章

客户签名	采购	品质	工程	核准	客户盖章

1. 简介:

KGK-0038AM 内含高速高灵敏度 PIN 光电二极管和低功耗、高增益前置放大 IC, 采用环氧树脂塑封封装设计, 该产品已经通过 REACH 和 ROHS 认证属于环保产品, 在红外遥控系统中作为接收器使用。

2. 特性:

- 小体积环氧塑封封装设计;
- 宽工作电压, 2.7-5.5V;
- 低功耗; 宽角度及长距离接收;
- 抗干扰能力强; 能抵挡环境干扰;
- 输出匹配 TTL、CMOS 电平, 低电平有效。

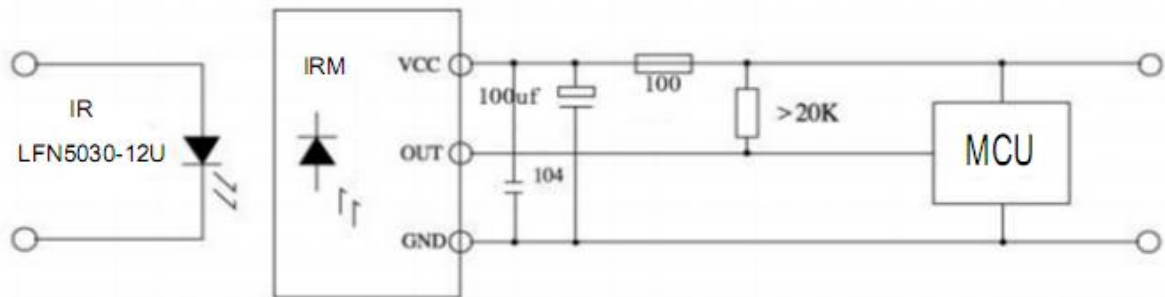
3. 应用:

- 视听器材(车载 MP3、MP4, 硬盘播放器等);
- 游戏(遥控飞机、汽车, 车载游戏机等);
- 其它红外线遥控产品。

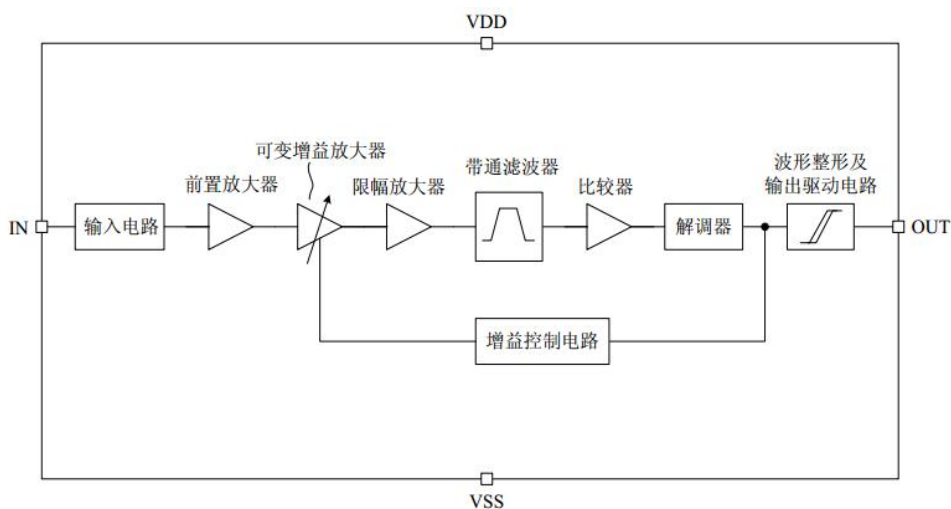
实物图



4. 应用电路图:



5. 原理图:





6. 光电参数(T=25℃ Vcc=5.0v f₀=38KHZ):

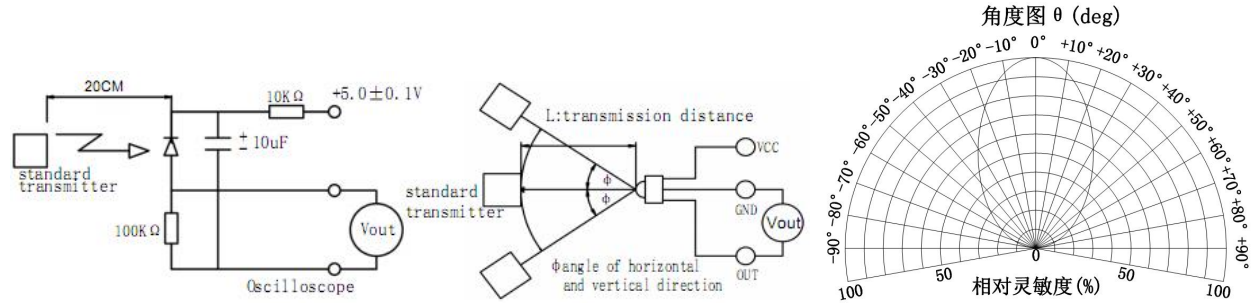
参 数	符号		测试条件	Min	Type	Max	单位
工作电流	I _{cc}		VDD=5v	0.2	0.3	0.5	mA
接收距离	L	0°	※	7	9		M
	L	左 35°	※	3	4		M
	L	右 35°	※	3	4		M
载波频率	f ₀				37.9		kHz
BPF 宽度	f _{BW}			—	7.4	—	kHz
低电平输出	V _{OL}		I _{sink} =2.0mA			250	mV
高电平输出	V _{OH}		VCC=5V	VCC-0.3		VCC	V
输出脉冲 宽 度	T _{PWL}		burst wave Vin=500μv p-p	400	600	800	μ S
	T _{PWH}		burst wave Vin=50mV p-p	400	640	800	μ S
最小脉冲宽度	T _{burst}		Vin=50mV p-p	350			us
最小间隔时间	T _{burst gap}		Vin=50mV p-p	400			us
编码停顿时间	T _{pause}		Vin=50mV p-p	40			ms

※发射为 LFN5030-12U, 室内无阳光直射接收窗, 前上方 1M 置 40W 电子整流日光灯干扰, 灯光强度为 200±50Lux。

7. 兼容编码列表:

NEC/RC5_Philips.

8. 接收角度测试方式:



9. 推荐使用条件:

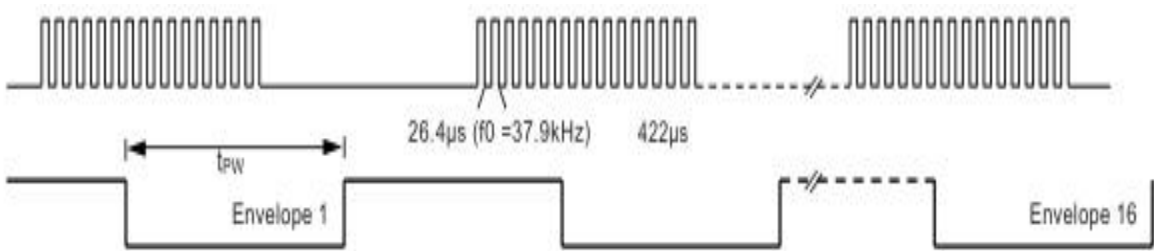
项目	符号	Min	Typ	Max	单位
工作电压	V _{DD}	2.7	-----	5.5	V
输入频率	FM		37.9		kHz
工作温度	Topr		25		℃

10. 极限参数:

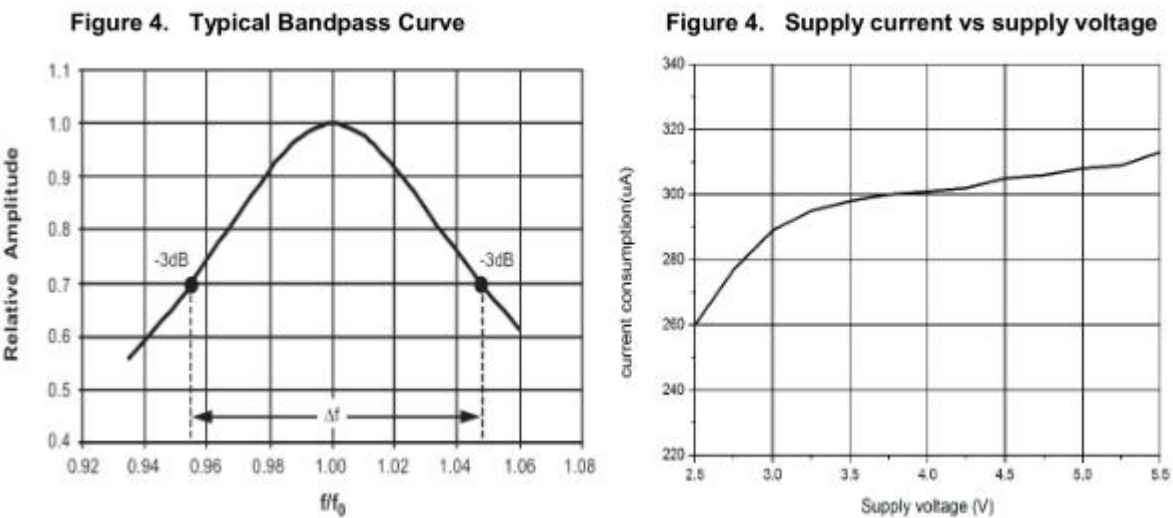
项目	符号	规格	单位
供应电压	V _{DD}	6.0	V
储存温度	T _{stg}	-40 — +125	℃
*焊接温度	T _{sol}	260±5 (5S 以内)	℃

*指产品处于非受力状态下的焊接温度，焊接距离距产品胶体与引脚根部 2.0mm 以上。

11. 测试波型:



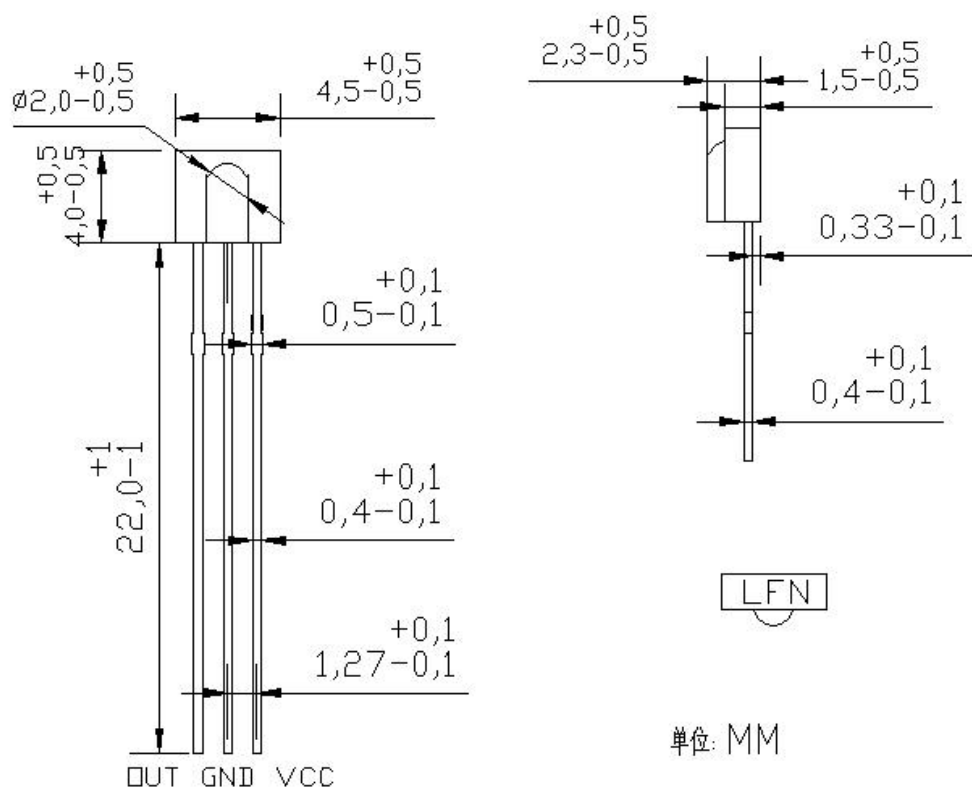
12. 特性曲线图 (Characteristics Curve) (Tamb=25℃ unless otheruise specified):



13. 可靠性测试:

测试项目	测试条件	测试时间	测试数	合格数
焊接耐热温度	温度 260℃±5℃ （非受力状态下）	5 秒以内	20	20
静电破坏实验	电容 100PF, 电阻 1.5kΩ, 静电电压 4KV, 各引脚		20	20
振动实验	频率：10-50Hz/1min 振幅：1.5mm X、Y、Z/30min	30 分钟	20	20
高温储存	温度 85℃±2℃	240 小时	20	20
低温储存	温度 -20℃±2℃	240 小时	20	20
高温高湿储存	温度 85℃；湿度 85%	240 小时	20	20
高低温循环	低温 -20℃（30 秒）， 高温 85℃（30 秒）	10 个循环	20	20
引脚弯曲	用 2.5N 的外力对每个引脚弯曲 2 次		20	20

14. 尺寸:



15. 使用注意事项:

1). 焊接条件:

波峰焊或浸锡炉: 请在 260°C 且 5 秒以内一次焊接完成, 同时应避免树脂胶体浸入锡槽内, 焊点需离引脚与树脂胶体根部 2mm 以上。

烙铁: 用 30W 的烙铁, 其尖端温度不得高于 350°C , 且在 3 秒以内一次焊接完成, 焊点需离引脚与树脂胶体根部 2mm 以上。

回流焊: 不适用。

备注: 焊接时请勿对产品施加外力, 注意避免引脚遭受腐蚀或变色, 否则会造成焊接困难, 建议尽早及时使用。

2). 线路板上的安装孔间距请与产品脚间距离保持一致, 否则经过焊接后会有造成内部线路损伤的风险。

3). 引脚弯折成型条件: a. 弯折离树脂胶体根部 2MM 以上。b. 必须在焊接前完成。

4). 产品在高温状态下进行载切引脚容易产生性能不良, 请在产品恢复至常温下或焊接前进行引脚载切。

5). 在焊接温度回到正常以前, 必须避免使产品受到任何的震动或外力。

6). 请注意保护红外线接收器的接收面, 沾污或磨损后会影响接收效果, 切勿用高腐蚀性溶剂对产品进行清洗, 以免腐蚀产品影响性能, 推荐使用酒精擦拭或浸渍且在常温下不得超过 3 分钟。

7). 静电防护: 产品为静电敏感元件, 在使用时需要注意静电的电涌会损坏或破坏产品, 与产品接触的工作台请用导电的台垫通过电阻接地; 烙铁的尖端一定要接地; 推荐使用离子发生器。



16. 产品命名方式:

LF	00	38	G	K	JN
L O G O		中 心 频 率		支 架 代 码	芯 片 代 码
	产品外形型号				

17. 包装方式:

1). 防静电袋（如右图）

产品标签：正贴于防静电袋正中间

尺寸：140mm × 170mm

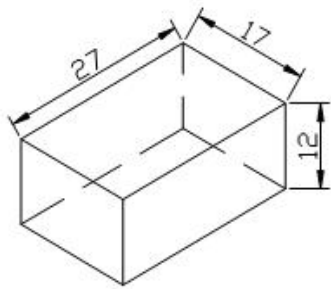
数量：每包 500PCS

2). 外装箱

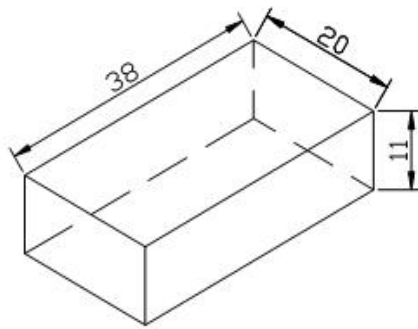
产品标签：正贴于外装箱侧面的左上角

尺寸：如下图（小、中、大）三种尺寸

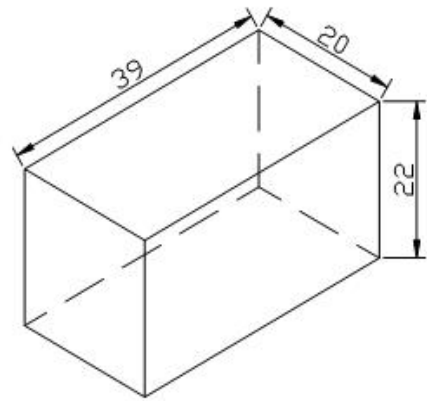
数量：小于 5K 使用小箱包装，5. 5K-10K 使用中箱包装，10. 5K-20K 使用大箱包装



小箱：27 X 17 X 12 H



中箱：38 X 20 X 11 H



大箱：39 X 20 X 22 H